U Scystem teolerik:

MPI - Festlionses forseling
Stritzant - Bissuan.

### Veranstalter

Fachausschuß »Mikroelektronik und Mikromechanik« in der VDE/VDI-Gesellschaft Mikroelektronik und Forschungsgesellschaft für Feingeräte-, Mikro- und Uhrentechnik e.V., Stuttgart

## Programmausschuß

Dr. W. Menz (Vorsitzender) Robert Bosch GmbH Technisches Zentrum Forschung Postfach 10 60 50, 7000 Stuttgart 10 Telefon: 0711/811 - 63 84

## Dr. S. Büttgenbach

Forschungsinstitut der Forschungsgesellschaft für Feingeräte-, Mikro- und Uhrentechnik e.V. Breitscheidstraße 2b, 7000 Stuttgart 1 Telefon: 0711/121 - 37 13

Dr. W. Kulcke IBM Deutschland GmbH Zentrum für Produktionstechnik 7032 Sindelfingen Telefon: 07031/91 - 3861

Dr. H. Seidel Messerschmitt - Bölkow - Blohm GmbH Abteilung ZTA Postfach 80 11 09, 8000 München 80 Telefon: 089/6000 - 7387

Im Rahmen dieser Veranstaltung sollen drei Themenbereiche bevorzugt abgehandelt werden:

Technologische Grundlagen Neue Anwendungen Systemkonzepte

### Programm

# Mittwoch, 11. Januar 1989

10.00 Eröffnung W. Berger, Vorsitzender des Fachausschusses » Mikroelektronik und Mikromechanik « der VDE/VDI-Gesellschaft Mikroelektronik und Vorsitzender der Forschungsgesellschaft für Feingeräte-, Mikro- und Uhrentechnik e.V.

# Einführung

10.10 Perspektiven der Mikrosystemtechnik W. Kroy, Messerschmitt - Bölkow - Blohm GmbH. München

#### Technologische Grundlagen

(Sitzungsleiter: W. Kulcke)

10.35 Mechanismus des anisotropen Siliziumätzens H. Seidel. Messerschmitt - Bölkow - Blohm GmbH. München

Mikrostrukturierung durch reaktives Ionenätzen J. Greschner, IBM, Sindelfingen

11.35 - 11.30 Pause

- 11.50 Methoden der Spannungskompensation in mikromechanischen Bauelementen
   L. Csepregi, Fraunhofer Institut für Festkörpertechnologie, München
- 12.10 Messung von inneren Spannungen an dünnen Si Membranen
   W. Engelhardt, IBM, Sindelfingen
- 12.30 Analyse der Defektursachen und der Genauigkeit der Strukturübertragung bei der Röntgentiefenlithografie mit Synchrotronstrahlung J. Mohr, Universität Karlsruhe W. Ehrfeld, D. Münchmeyer, KfK, Karlsruhe
- 12.50 Vertikale Integrationstechnik Technologie und Schaltungskonzepte
   P. Seegebrecht, Fraunhofer - Institut für Festkörpertechnologie, München
- 13.10 14.10 Mittagspause

# Neue Anwendungen

(Sitzungsleiter: H. Seidel)

- 14.10 MikrooptikE. Voges, Universität Dortmund
- 14.40 Herstellung und Anwendung digitaler Phasengitter
   H. Dammann, R.-D. Böhnke, G. Rabe, Philips GmbH, Forschungslaboratorium Hamburg
- 15.00 Möglichkeiten des Einsatzes akustischer Oszillatoren als Mikrosensoren S. Büttgenbach, FFMU, Stuttgart
- 15.20 Thermomechanische Mikroaktoren W. Benecke, W. Riethmüller, A. Heuberger. Fraunhofer - Institut für Mikrostrukturtechnik, Berlin
- 15.40 Einsatz eines Elektronenstrahlschreibers zur Herstellung von Röntgenmasken P. Bley, Institut für Mikrostrukturtechnik, KfK, Karlsruhe
- 16.00 16.15 Pause

### Mikrosystemtechnik

(Sitzungsleiter: S. Büttgenbach)

- Signalverarbeitungskonzepte bei Mikrosystemen
   Pointer, H.-R. Tränkler, Hochschule der Bundeswehr, München
- 16.45 Von der Mikroperipherik zur Mikrosystemtechnik
   T. Grandke, Siemens AG, Erlangen
- 17.05 Simulationswerkzeuge für MikrosystemeR. Dümcke, Technische Universität Berlin
- 17.25 Mikromechanische Komponenten für optoelektronische Systeme
   R. Müller Fiedler, J. Schweikhardt,
   Robert Bosch GmbH, Stuttgart

### Ausblick

- 17.45 Mikrosystemtechnik Herausforderung und Chance für die mittelständische Industrie H.-P. Lorenzen, Bundesministerium für Forschung und Technologie, Bonn
- 18.00 Ende der Veranstaltung

## Allgemeine Hinweise

### **Tagungsort**

Max-Planck-Institut für Festkörperforschung, Heisenbergstraße 1, 7000 Stuttgart 80 (Büsnau), Hörsaal 2D5

## Tagungsbüro

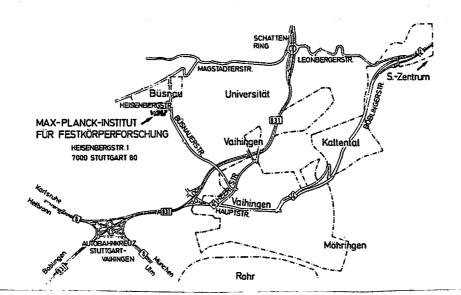
Telefon: 0711/6860-771 (nur besetzt am 11. Januar 1989)

### Verkehrsverbindungen

Ab Hauptbahnhof Stuttgart: S-Bahn-Linien S1, S2, S3 bis Haltestelle Universität, von dort Bus Nr. 84 oder 93 bis Haltestelle Max-Planck-Institut.

Verbindung zwischen Flughafen und Hauptbahnhof: alle 20 Minuten mit Flughafen-Schnellbus Linie A.

Mit Kraftfahrzeug: Zufahrt von der Autobahnausfahrt (A 831) Stuttgart-Valhingen oder von der Autobahnausfahrt (A 81) Leonberg Richtung Stuttgart.



Beiges -> Begriping	
v. Klitning:	C
- Forsdung i'm Halb leiter Leverich	
- Anglot por Insommen abeit  - Orfording kleinster Stricktore  6 din 1- din . System  6 Box: (0.1 µm) <sup>3</sup>	
(a) Box: (0.1 mm)	
- Frisamen arbeit -> u System teel.	
1) Wiss. Vorträge:	
Dr. Kroy (MBB)	
µ Systeme → Oph'4	
* Optili: mech. Boardenste (em, du - Breid)	
Problem: Phasen in formation gelit valore (1) ibration, etc.)	
(Vibration, etc.)  - Milliatinsiering d. med. Bourteile	,
AVT-gebiet (leiting: Reichelt; Berlin)	
Def: urgstem teelwih	
- Fündschonen integriet	
- Für hetionen integriet  - Weekerl wir hinge  - I tri leter gripe  - Widt ele letrische Parameto	
- Widt ele Citris de l'araneto	